

LED应用封装常见要素简析

led应用封装技术对LED的散热，寿命等基本参数至关重要，本文对LED封装常见要素进行简单介绍分析，供LED相关人员参考。

一、LED引脚成形方法

- 1.必需离胶体2毫米才能折弯支架。
- 2.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
- 3.支架成形必须在焊接前完成。
- 4.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

二、LED弯脚及切脚时注意

因设计需要弯脚及切脚，在对LED进行弯脚及切脚时，弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。

弯脚应在焊接前进行。

使用LED插灯时，pcb板孔间距与LED脚间距要相对应。

切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电，故机器要可靠的接地，做好防静电工作（可吹离子风扇消除静电）。

三、LED清洗

当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

四、LED过流保护

过流保护能是给LED串联保护电阻使其工作稳定

电阻值计算公式为： $R = (VCC - VF) / IF$

VCC为电源|稳压器电压，VF为LED驱动电压，IF为顺向电流

五、LED焊接条件

- 1.烙铁焊接：烙铁（最高30W）尖端温度不超过300，焊接时间不超过3秒，焊接位置至少离胶体2毫米。
- 2.波峰焊：浸焊最高温度260，浸焊时间不超过5秒，浸焊位置至少离胶体2毫米。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/18644.html>